**微电子毕业论文选题**

　　微电子技术是随着集成电路，尤其是超大型规模集成电路而发展起来的一门新的技术。微电子学主要掌握大规模集成电路及新型半导体器件的设计、制造及测试所必需的基本理论和方法，具有电路分析、工艺分析、器件性能分析和版图设计等的基本能力。接下来是学术堂收集整理的微电子毕业论文选题，欢迎大家阅读。  
　　  
　　**微电子毕业论文选题一：**  
　　  
　　[1]陈俊，王学毅，谭琦，杜金生，吴建。 键合SOI材料应力的控制技术[J]. 微纳电子技术，2017,（05）：304-310.  
　　[2]白琼，张斌珍，段俊萍，黄成远，王颖。 基于新型谐振柱的高频波导滤波器的设计[J]. 微纳电子技术，2017,（05）：324-328+363.  
　　[3]肖咸盛，杨拥军，卞玉民，张旭辉。 一种汽车碰撞试验用低阻尼宽频响加速度传感器[J]. 微纳电子技术，2017,（05）：329-335+341.  
　　[4]马世童。 当前集成电路的发展现状及未来趋势[J]. 通讯世界，2017,（07）：300.  
　　[5]黄诗浩，孙钦钦，谢文明，汪涵聪，林抒毅，陈炳煌。 不同直径张应变锗材料对光谱和晶体质量的影响[J]. 半导体技术，2017,（04）：305-309.  
　　[6]刘坤，曼苏乐。 应用于微电网的新型潮流控制器[J]. 电气自动化，2017,（02）：60-62.  
　　[7]许吉强，卢闻州，吴雷，沈锦飞，惠晶。 低压微电网逆变器并离网平滑切换控制[J]. 科学技术与工程，2017,（09）：36-43.  
　　[8]刘旭，姜克强。 限流接闪器在高层建筑中的应用[J]. 建筑电气，2017,（03）：18-21.  
　　[9]莫大康。 中国半导体业需要多元化推动力[N]. 中国电子报，2017-03-24（008）。  
　　[10]Mary. 我国在3D NAND存储器研发领域取得标志性进展[J]. 今日电子，2017,（03）：25-26.  
　　[11]刘民哲，王泰升，李和福，刘震宇，陈佐龙，鱼卫星。 静电场辅助的微压印光刻技术[J]. 光学精密工程，2017,（03）：663-671.  
　　[12]李展征。 大功率高频开关电源的设计探讨[J]. 电子世界，2017,（05）：129-130.  
　　[13]杜高明，李向阳，马世碧，宋宇鲲，张多利。 基于多路径路由片上网络的低功耗联合编码电路设计[J]. 微电子学与计算机，2017,（03）：86-89.  
　　[14]曹璐，刘宏，田彤。 一种采用数字修调技术的低温漂带隙基准设计[J]. 电子设计工程，2017,（05）：150-153+157.  
　　[15]. 研制出首个稳定可控的单分子电子开关器件[J]. 机床与液压，2017,（04）：141.  
　　[16]. 石墨烯在室温下实现自旋过滤[J]. 炭素技术，2017,（01）：38.  
　　[17]赵善通。 对低成本机械自动化技术的几点思考[J]. 科技与创新，2017,（04）：27-28.  
　　[18]李伟，李杰超，李卓，闫卫平。 矩形微槽道结构与平板微热管传热特性研究[J]. 热能动力工程，2017,（02）：42-46+136.  
　　[19]袁源，刘丽莉，黄亚文，杨军校。 新型苯并环丁烯官能化POSS及其衍生聚合物的制备与表征[J]. 化工新型材料，2017,（02）：52-54.  
　　[20]李爽，邵惠奇，林芳兵，蒋金华，陈南梁。 镀铜导电聚酰亚胺纤维的制备及其性能研究[J]. 化工新型材料，2017,（02）：55-57.  
　　[21]赵万良，成宇翔，孙殿竣，唐健，刘朝阳，欧彬，张卫平。 MEMS半球谐振陀螺的角速度积分及其FPGA设计[J]. 半导体光电，2017,（01）：40-44.  
　　[22]王前双，尹昌新，常乾坤，杨涛。 直流微电网运行控制策略研究[J]. 电器与能效管理技术，2017,（03）：34-39.  
　　[23]赵泽华，王枭，张涛。 浅谈机电一体化技术[J]. 南方农机，2017,（03）：124+128.  
　　[24]王荣理，陈志平，施浒立，李春光，李佳威。 基于GPS/BDS技术的软件测长仪[J]. 电子机械工程，2017,（01）：60-64.  
　　[25]段宝岩。 大型空间可展开天线的研究现状与发展趋势[J]. 电子机械工程，2017,（01）：1-14.  
　　[26]任秀江，谢向辉，施晶晶。 基于ECC校验码的存储器可扩展自修复算法设计[J]. 计算机工程与科学，2017,（02）：252-257.  
　　[27]马浩，杨瑞霞，李春静。 层状二硫化钼材料的制备和应用进展[J]. 材料导报，2017,（03）：7-14.  
　　[28]. 重庆成功研制液晶面板和触摸屏等光刻装备[J]. 电子世界，2017,（03）：15.  
　　[29]宋飞，杨扬。 小型无人机视频实时传输的设计与开发[J]. 电子技术与软件工程，2017,（03）：184.  
　　[30]刘川。 野战炮兵精确弹药的最新发展[J]. 坦克装甲车辆，2017,（03）：26-32.  
　　[31]甘平。 探究电子信息技术的应用特点[J]. 科技创新与应用，2017,（03）：82.  
　　  
　　**微电子毕业论文选题二：**  
　　  
　　[32]任志鑫，徐世伟，梁东。 信息化技术对机械发展的影响分析[J]. 南方农机，2017,（01）：103.  
　　[33]张健宏。 管窥机械设计制造及其自动化的发展方向[J]. 甘肃科技纵横，2017,（01）：55-57.  
　　[34]陆玉。 电力电子变压器在混合微电网中的应用[J]. 黑龙江科技信息，2017,（03）：151.  
　　[35]王鹏。 探析微电子设计自动化技术研究与应用[J]. 通讯世界，2017,（02）：257-258.  
　　[36]寇伟，庄瑾。 一种分布式协同干扰的功率分配算法[J]. 电子世界，2017,（02）：156+158.  
　　[37]徐修远。 220 kV内桥接线方式数字化变电站继电保护验收难点研究[J]. 贵州电力技术，2017,（01）：66-69.  
　　[38]张雪芹，尚忠，于建波。 密封微电子器件真空烘烤工艺研究[J]. 电子与封装，2017,（01）：6-9.  
　　[39]李文辉。 智能化数控技术的发展探究[J]. 科技创新与应用，2017,（02）：158.  
　　[40]王辉，庞婷。 多芯片真空共晶工装设计方法研究[J]. 电子工艺技术，2017,（01）：12-13+52.  
　　[41]赵正平。 微系统三维集成技术的新发展[J]. 微纳电子技术，2017,（01）：1-10.  
　　[42]燕丰。 一类同时含三氟甲基和低聚倍半硅氧烷结构杂化聚酰亚胺及其制备方法[J]. 橡塑技术与装备，2017,（02）：7.  
　　[43]程红斌。 高山电视转播台防雷关键技术研究[J]. 技术与市场，2017,（01）：37+39.  
　　[44]叶瑞优。 中科院阻变存储器高密度集成研究获进展[J]. 军民两用技术与产品，2017,（01）：25.  
　　[45]关今羽，刘旭颖，王可。 火力发电厂智能型电动执行机构的特点[J]. 电站系统工程，2017,（01）：73-74.  
　　[46]赵燕琪，王云涛。 电力通讯设备防雷保护探析[J]. 通讯世界，2017,（01）：188-189.  
　　[47]谢乃冰。 机械设计制造及其自动化的发展方向[J]. 科技展望，2017,（01）：63.  
　　[48]韦凯，裴永茂。 轻质复合材料及结构热膨胀调控设计研究进展[J]. 科学通报，2017,（01）：47-60.  
　　[49]钱傅军。 智能漏电保护器防雷技术的研发与应用[J]. 科技展望，2017,（01）：109.  
　　[50]裴景波。 现代数字化机械设计技术分析[J]. 河北农机，2017,（01）：42+44.  
　　[51]王成山，李微，王议锋，孟准，杨良。 直流微电网母线电压波动分类及抑制方法综述[J]. 中国电机工程学报，2017,（01）：84-98.  
　　[52]范丽芳。 芯片安全防护技术助力指纹识别系统安全[J]. 电子产品世界，2017,（01）：72-73+36.  
　　[53]张晓仙。 基于封装工艺的电动机变频调速系统研究[J]. 南方农机，2016,（12）：109+133.  
　　[54]曾洲，罗豪苏。 智能可穿戴式压电能量收集器研究现状[J]. 现代物理知识，2016,（06）：31-39.  
　　[55]张晓仙。 小型电动机变频调速系统集成技术研究[J]. 现代制造技术与装备，2016,（12）：66+68.  
　　[56]严楷。 模拟空间环境下电接触薄膜失效行为及机理研究[D].北京科技大学，2017.  
　　[57]于周顺。 硅基微机械加工技术[J]. 电子世界，2016,（23）：161.  
　　[58]郑亚鹏。 光控分子开关的电子输运性质研究[D].江南大学，2017.  
　　[59]刘根，蒋澄灿，芮晓光，廖黎莉，芮延年。 工业超洁净环境设计关键技术的研究[J]. 机械设计与制造工程，2016,（11）：86-91.  
　　[60]雷勇颋。 微电子封装技术的优势与应用[J]. 技术与市场，2016,（11）：99.  
　　[61]丁志建。 微电子控制机电设备在工业中的实际应用探讨[J]. 河北农机，2016,（11）：48.  
　　[62]夏求应。 全固态薄膜锂电池三维薄膜正极阵列构建[A]. 中国硅酸盐学会固态离子学分会。第18届全国固态离子学学术会议暨国际电化学储能技术论坛论文集[C].中国硅酸盐学会固态离子学分会：,2016:1. 　　**微电子毕业论文选题三：**  
　　  
　　[63]何立民。 物联网时代微控制器的服务转型[J]. 单片机与嵌入式系统应用，2016,（11）：3-4+20.  
　　[64]黄晗。 超低功耗集成电路技术综述[J]. 科技展望，2016,（30）：171.  
　　[65]周海澎。 基于自旋转移矩效应逻辑器件的建模[D].电子科技大学，2016.  
　　[66]张明文。 当前微电子学与集成电路分析[J]. 无线互联科技，2016,（17）：15-16.  
　　[67]曾晓洋，黎明，李志宏，陈兢，杨玉超，黄如。 微纳集成电路和新型混合集成技术[J]. 中国科学：信息科学，2016,（08）：1108-1135.  
　　[68]严向峰，汪剑侠。 微电子封装的热特性研究[J]. 船电技术，2016,（08）：41-43.  
　　[69]殷东平。 雷达先进制造技术现状与发展[J]. 电子机械工程，2016,（04）：1-6.  
　　[70]尹梦宾。 集成电路测试系统微小微电子参量校准技术研究[J]. 通讯世界，2016,（15）：225.  
　　[71]李宇航。 基于微电子激光转印的热力耦合模型[A]. 中国力学学会。力学与工程应用（第十六卷）[C].中国力学学会：,2016:1.  
　　[72]刘林杰，崔朝探，高岭。 一种新型封装材料的热耗散能力分析与验证[J]. 半导体技术，2016,（08）：631-635.  
　　[73]曹燕强。 原子层沉积制备几种纳米薄膜、纳米复合结构及其在微电子和储能器件中的应用研究[D].南京大学，2016.  
　　[74]康富春，彭定芬，林东恩。 微电子级液体环氧树脂的制备[J]. 热固性树脂，2016,（04）：5-6+15.  
　　[75]徐昌一。 石墨烯应用于GaN基材料的研究进展[J]. 发光学报，2016,（07）：778-785.  
　　[76]吴举才。 基于碘吸收谱外调制三次谐波解调的Nd:YAG激光器稳频技术研究[D].哈尔滨工业大学，2016.  
　　[77]魏新明，沈平，单修洋，李渭松。 基于数值仿真的气动喷射阀回流间隙的优化[J]. 工程设计学报，2016,（03）：244-250.  
　　[78]魏玉明，陈长英，陈麟。 硅基周期槽结构的刻蚀工艺研究[J]. 光学仪器，2016,（03）：272-277.  
　　[79]吴勇翀，刘艳峰。 新型微机电系统的光纤传感器设计及应用[J]. 光通信技术，2016,（06）：47-49.  
　　[80]AET. AMD伸援手提升中国高端处理器封测技术水准[J]. 电子技术应用，2016,（06）：3.  
　　[81]王丹。 脉冲调制射频容性耦合H\_2放电流体/蒙卡模拟[D].大连理工大学，2016.  
　　[82]李江江。 横向结构ZnO纳米线阵列紫外探测器件的研究[D].北京工业大学，2016.  
　　[83]陈金玉。 基于在线敲出技术和RTCA分析的龙眼核多酚关键抗氧化功能因子的快速筛选与活性评价[D].华中农业大学，2016.  
　　[84]侯明浩。 微电子计算机网络安全[J]. 时代农机，2016,（05）：30+32.  
　　[85]李波，夏俊生，李寿胜。 厚膜混合微电子芯片共晶焊工艺研究[J]. 新技术新工艺，2016,（05）：6-10.  
　　[86]陆向宁，何贞志，胡宁宁，宿磊，聂磊。 主动红外热成像焊球缺陷检测方法研究[J]. 机械工程学报，2016,（10）：17-24.  
　　[87]梁赪。 宏孔导电网络架构下的纳米石墨烯-氢氧化钴[D].华东师范大学，2016.  
　　[88]顾晓清。 微电子技术在航空系统中的发展[J]. 电子制作，2016,（10）：44.  
　　[89]史燕。 基于微电子传感信号的机械设备自动控制探究[J]. 产业与科技论坛，2016,（09）：42-43.  
　　[90]李勇，许高斌，陈兴，马渊明。 基于RF MEMS开关的4位分布式移相器的设计[J]. 仪表技术与传感器，2016,（05）：29-31+43.  
　　[91]叶升涛。 Co掺杂Mg\_xZn\_（1-x）O薄膜的微结构及磁性研究[D].山东大学，2016.  
　　[92]赵亳。 离子束溅射生长Ge/Si量子点及其光敏电阻的初步研究[D].云南大学，2016.  
　　[93]韩晓倩。 聚酰亚胺-b-聚脲共聚物薄膜的制备研究[D].大连理工大学，2016.  
　　  
　**微电子毕业论文选题四：**  
　　  
　　[94]张璐。 全人工恒定光环境下流水线工人的疲劳周期研究[D].重庆大学，2016.  
　　[95]赵雪琳。 真空微电子加速度传感器控制与检测电路设计与实验[D].重庆大学，2016.  
　　[96]姜峰。 基于临时键合拿持技术的硅通转接板背面工艺优化研究[D].中国科学院大学（工程管理与信息技术学院），2016.  
　　[97]徐宁。 汞离子检测的电化学DNA传感器研究[D].浙江大学，2016.  
　　[98]文延东。 基于软件无线电的移动通信系统研究与设计[D].湖南大学，2016.  
　　[99]赵德生。 50HZ微电子相敏轨道电路接收器系统的设计[J]. 铁道运营技术，2016,（02）：22-24+27.  
　　[100]罗静。 微电子器件的静电防护探讨[J]. 通讯世界，2016,（08）：250.  
　　[101]. 新型光载流子辐射技术强化半导体材料特性测量[J]. 传感器世界，2016,（04）：44.  
　　[102]潘泰松。 二维层状晶体场效应器件电学性质的温度效应研究[D].电子科技大学，2016.  
　　[103]万珊。 有机硅弹性体的热循环性能与填料用量的关系[J]. 橡胶参考资料，2016,（02）：35-38.  
　　[104]曹宏耀。 微电子器件三维叠层封装技术仿真系统的设计[D].西南交通大学，2016.  
　　[105]徐振龙。 磁力耦合压电电磁复合俘能器发电特性研究[D].哈尔滨工业大学，2016.  
　　[106]徐帅，华丽，候汉娜。 水热法合成磁性纳米微球NiFe\_2O\_4及其电化学稳定性分析[J]. 吉林大学学报（理学版），2016,（02）：388-390.  
　　[107]季兴桥，李悦，彭挺。 基于硅铝合金微电子集成工艺研究[J]. 电子工艺技术，2016,（02）：74-76+84.  
　　[108]王宽，刘敬成，刘仁，穆启道，郑祥飞，纪昌炜，刘晓亚。 光刻胶用底部抗反射涂层研究进展[J]. 影像科学与光化学，2016,（02）：123-135.  
　　[109]杨金显，陈超，李志鹏。 基于小波卡尔曼混合算法的陀螺仪去噪方法[J]. 电子测量技术，2016,（03）：29-33+37.  
　　[110]黄文俊。 掺杂单层磷烯的电子结构及输运特性研究[D].电子科技大学，2016.  
　　[111]李嘉。 金丝引线键合工艺参数对键合质量影响规律的研究[D].内蒙古工业大学，2016.  
　　[112]胡鹏飞。 MOSFET源/漏电阻的分析与拟合计算[D].安徽大学，2016.  
　　[113]衣畅。 基于多晶硅纳米膜的角速度敏感结构设计[D].沈阳工业大学，2016.  
　　[114]钱学成。 地磁暴对轨道电路的影响探究[D].北京交通大学，2016.  
　　[115]田奇昌。 痕量多溴联苯醚的全二维气相色谱分离分析方法的研究[D].沈阳工业大学，2016.  
　　[116]郝嵘，高国伟，潘宏生，何刚，马超。 一种MEMS加速度计的温度误差补偿方法[J]. 北京信息科技大学学报（自然科学版），2016,（01）：38-42.  
　　[117]邱中全，郭常宁。 电子组装喷射点胶过程流体特性CFD模拟分析[J]. 电子科技，2016,（02）：112-115.  
　　[118]邓杰，乐李菊，王茂荣。 浅谈微电子控制机电设备在工业中的作用[J]. 黑龙江科技信息，2016,（04）：2.  
　　[119]郁万成，陈秀芳，胡小波，徐现刚。 SiC衬底上近自由态石墨烯制备及表征的研究进展[J]. 人工晶体学报，2016,（01）：1-9+14.  
　　[120]程江洁。 微电子电路的校准技术和自动测试探索[J]. 科技传播，2016,（01）：42+60.  
　　[121]杨亚非。 微电子封装的关键技术及应用前景研究[J]. 信息与电脑（理论版），2016,（01）：41+43.  
　　[122]徐图。 微电子封装器件热失效分析与优化设计[D].南京理工大学，2016.  
　　[123]刘进壮。 掺杂钙硼硅微晶玻璃制备及性能研究[D].浙江大学，2016.  
　　[124]杨嘉力。 基于三维运动平台的点胶系统研究[D].哈尔滨工业大学，2016.  
　　[125]赵开元。 电压激励微梁非线性系统随机振动[D].华北理工大学，2016.